

双组份电源灌封胶价格硅橡胶灌封胶促销

产品名称	双组份电源灌封胶价格硅橡胶灌封胶促销
公司名称	肇庆市皓明有机硅材料有限公司
价格	2.00/KG
规格参数	品牌:皓明 型号:HM-312D 混合后粘度(CP):3500 ~ 4500
公司地址	佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A8栋15楼I213室
联系电话	137-26680716 13726680716

产品详情

双组份电源灌封胶价格硅橡胶灌封胶促销

hm-312d 使用说明书

肇庆皓明有机硅专业生产灌封胶、双组份电源灌封胶，硅橡胶灌封胶，灌封胶水、led灌封胶、电子灌封胶、环氧灌封胶、导热灌封胶等，更多产品信息，请联系相关业务详情请咨询：电话：13726680716苏's qq：2279359498

一、产品介绍

hm-312d是在双组份缩合型有机硅密封材料基础上，配有导热性能的产品。可常温固化，固化过程中放出乙醇分子，对pc(poly-carbonate)、pp、abs、pvc、铜线等材料不会产生腐蚀。对大部分电子配件材料(pp、pe除外)附着力良好。

二、产品特点

- 粘度适中，流平性好，适用于复杂电子配件的模压。
- 固化后形成柔软的橡胶状，抗冲击性好。
- 耐热性、耐潮性、耐寒性优秀，应用后可以延长电子配件的寿命。
- 缩合型，脱出的乙醇分子对元器件无腐蚀。

- 本产品无须使用其它的底漆，对pc(polycarbonate)，epoxy等材料具有出色的附着力。
- 具有极佳的防潮、防水效果。用本产品灌封的led显示屏，可达到ip68防水等级。
- 哑光效果优异,特别适合有哑光要求的场合肇庆皓明有机硅专业生产灌封胶、双组份电源灌封胶，硅胶灌封胶，灌封胶水、led灌封胶、电子灌封胶、环氧灌封胶、导热灌封胶等，更多产品信息，请联系相关业务详情请咨询：电话：13726680716苏's qq：2279359498

三、用途

户内外led显示屏灌封

四：典型物性

混合前物性 (25 , 65%rh)		
组分	312d a	312d b
颜色	黑色或白色	半透明溶液
粘度 (cp)	5000 ~ 7000	25
比重	1.10-1.20	0.97
混合后物性 (25 , 65%rh)		
混合比例(重量比)	a : b : c = 100 : 6 : 1	
颜色	黑色或白色	
混合后粘度(cp)	3500 ~ 4500	
操作时间 (min)	30 ~ 60	
完全硬化时间 (h)	24	
固化7 d , 25 , 65%rh		

硬度 (shore a)	20-35
最大拉伸强度 (kg f/cm ²)	3
断裂伸长率 (%)	200
介电强度(kv/·mm)	25
介电常数(1.2mhz)	2.8
体积电阻率(·cm)	1.0 × 10 ¹⁵
导热系数/w/m/k	0.7

混合 使用时将a, b按照10 : 0.6的比例混合均匀, 体积比重量比均可, 简化了配比加工过程。在两组份充分混合后, 用真空泵对胶料进行排泡, 注意胶量不要超过容器的三分之一, 以免排泡时胶料溢出。也可静置排泡, 25 °C下20~30分钟即可自然排出气泡。

浇注胶料并固化 将混合好的胶料尽可能快地浇注在需要灌封的部位, 避免空气在浇注时混入。在常温下能够于24h内固化成弹性体, 温度降低会延长硫化时间, 调整a、b的比例能够加速硫化。

注意事项

1. 此硅橡胶属于缩合型反应固化, 一般按10 : 0.6混合均匀即可固化灌封; 如果需要加快或者减慢固化时间, 可适量调整a与b的比例。一般不建议加热固化, 以免表面及内部产生针孔或气泡, 影响美观和密封性能

2. 灌封厚度不要超过50mm。一般而言, 20mm以下的灌封厚度可以自然脱泡, 如果灌封厚度较大, 表面及内部容易产生针孔或气泡, 因此, 应把混合液放入真空容器中, 在700mmhg下脱泡至少5分钟。

3. 使用前请先将a、b组分各自充分搅拌均匀。

4. 颜色可以根据客户要求调整。

测试

客户有责任对所建议的密封胶的应用做相应的测试, 并决定该性能是否满足客户应用要求

储存与有效期

在30 以下密封保存。

a、b组分的有效期为自生产日期后十二个月。肇庆皓明有机硅专业生产灌封胶、双组份电源灌封胶，硅橡胶灌封胶，灌封胶水、led灌封胶、电子灌封胶、环氧灌封胶、导热灌封胶等，更多产品信息，请联系相关业务详情请咨询：电话：13726680716苏 ' s qq：2279359498

灌封胶在未固化前属于液体状，肇庆皓明有机硅材料有限公司创建于2003年，由台湾皓明企业和佛山森立有限公司（创立于1993年）共同创建，是一家专业从事有机硅及其相关应用的研发、生产与销售的合资企业。公司注重技术创新，于2012年建立了肇庆市首个有机硅工程技术研究开发中心。存在勾当性，胶液黏度遵守产物的材质、性能、生产工艺的分歧而有所分辨。灌封胶又称电子胶，是一个广泛的称号。用于电子元器件的粘接,密封,灌封和涂覆包庇。